

Prensa Manual Aquecida De 30 Toneladas Com Resfriador De Recirculação Integrado Para Ciclagem Térmica Rápida

Número do item: XP09



introdução

Prensa hidráulica manual aquecida de 30 toneladas com resfriamento ativo integrado para polímeros, compósitos e laminados eletrônicos. Controle de temperatura preciso até 300°C, placas de 300x300 mm e estrutura rígida de 260 kg garantem amostras uniformes. Completa com resfriador para ciclagem rápida. Sistema certificado pelo CE e pronto para uso.

[Saiba mais](#)

| Aplicação | Descrição | Principal Benefício |
|---|---|---|
| Vulcanização de Polímeros | Curagem de chapas de borracha natural e sintética em temperaturas e pressões controladas com precisão para otimizar a densidade de reticulação para pesquisa de juntas, vedações e pneus. | Aquecimento uniforme em placas grandes e capacidade de têmpera rápida evita a cura excessiva e garante propriedades mecânicas consistentes. |
| Laminação de Painéis Compósitos | Consolidação de pré-impregnados de fibra de carbono, aramida ou fibra de vidro em painéis rígidos para prototipagem aeroespacial e automotiva. | A estrutura sem deflexão garante espessura uniforme e colagem sem vazios, fundamental para a integridade estrutural. |
| Laminação de Circuitos Flexíveis Eletrônicos | Laminação multicamadas de circuitos flexíveis de poliimida, chaves de membrana e substratos de antenas RFID. | Placas ultraplacas e resfriamento controlado minimizam a empenamento, garantindo alinhamento de camadas e continuidade elétrica confiáveis. |
| Prensagem de Eletrodos/Folhas de Bateria | Compactação de filmes de cátodo e ânodo, camadas de eletrólito de estado sólido para baterias de íon de lítio e de próxima geração. | O resfriador integrado permite têmpera rápida para estabilizar fases metaestáveis e atingir níveis de porosidade precisos. |
| Estampagem a Quente de Micro/Nanoestruturas | Replicação de canais microfluídicos, grades ópticas e padrões de relevo superficial em wafers termoplásticos. | O paralelismo de placa em nível de micrometro garante replicação de profundidade uniforme e tensão residual mínima em grandes áreas. |
| Sinterização de PTFE / Polímeros de Alto Desempenho | Sinterização e prensagem por fusão de pós de PTFE, UHMWPE, PEEK ou poliimida em chapas ou pré-formas. | A grande área de aquecimento uniforme elimina pontos frios, alcançando cristalinidade homogênea e estabilidade dimensional. |
| Curagem de Borracha para Testes ASTM/ISO | Preparação de placas de teste de borracha para reômetro, testes de tração e dureza de acordo com ASTM D2084, D3182. | Perfis precisos de pressão e temperatura fornecem condições de teste repetíveis, garantindo comparação interlaboratorial válida. |
| Laminação de Dispositivos Médicos | Prensagem de filmes biocompatíveis, tiras de teste diagnóstico e adesivos transdérmicos com temperatura e pressão controladas. | O controle térmico delicado evita a degradação de biomateriais sensíveis ao calor, ao mesmo tempo que alcança uma laminação forte. |
| Prensagem de Painéis de CFRP Aeroespaciais | Curagem de camadas de fibra de carbono pré-impregnada para peças estruturais de aeronaves sob pressão e vácuo controlados. | A estrutura sem deflexão e o resfriamento rápido alcançam cristalinidade controlada e porosidade mínima. |

| Parâmetro | Especificação |
|--------------------------|--|
| Identificador do Modelo | XP09 |
| Força de Fixação Nominal | 0,0 – 30,0 Toneladas Métricas (0 – 300 KN) |
| Acionamento da Prensa | Bomba Hidráulica Manual de Dois Estágios |

| Parâmetro | Especificação |
|--|--|
| Espaçamento das Placas (Abertura Máxima) | 50 mm |
| Faixa de Temperatura | 0,0°C - 300,0°C (controle independente de placa dupla) |
| Dimensões das Placas (L×P) | 300 × 300 mm |
| Potência do Sistema de Aquecimento | 3000 W (2 cartuchos de aquecimento de 1500W por placa) |
| Resfriamento das Placas | Canais de refrigerante de cobre integrados, conexões de conexão rápida |
| Resfriador Compatível | Resfriador de Água de Recirculação Ativa (incluso) |
| Fonte de Alimentação | AC 220V - 230V, 50Hz, monofásico |
| Circuito Elétrico Recomendado | Tomada de parede dedicada de 16A |
| Peso Líquido | 260 kg |
| Dimensões Externas (L×P×A) | 458 × 480 × 466 mm |
| Certificação | Certificado pelo CE |